

2013-2017年中国半导体运 行态势与投资前景评估报告

报告目录及图表目录

智研数据研究中心 编制

www.abaogao.com

一、报告报价

《2013-2017年中国半导体运行态势与投资前景评估报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.abaogao.com/b/dianzi/338477T2DJ.html>

报告价格：印刷版：RMB 9800 电子版：RMB 9800 印刷版+电子版：RMB 10000

智研数据研究中心

订购电话： 400-600-8596(免长话费) 010-80993963

海外报告销售：010-80993963

传真： 010-60343813

Email： sales@abaogao.com

联系人： 刘老师 谭老师 陈老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

2012年全球半导体增长乏力，销售额仅同比微增0.4%。但随着智能手机、平板电脑、汽车电子等领域对半导体的需求持续扩大，2013年全球半导体市场景气状况将趋于好转。2012年第一季度，全球半导体营业收入比2011年第四季度温和下降3.6%，符合正常的季节模式。但第二季度营业收入仅比第一季度增长3.0%左右，从历史平均水平来看，非常疲软；第三季度，主要芯片供应商的营业收入环比增幅仅略高于6.0%。而2012年全球半导体销售额为3010亿美元，较2011年同比微增0.4%。得益于智能手机、平板电脑、汽车电子等领域对半导体需求的持续增长，2013年及以后一段时间，全球半导体市场景气状况将趋于好转。消费电子产品与互联网和移动互联网的紧密结合，导致手机、平板电脑、智能电视等网络接入终端产品的应用面持续扩大，随着各种电子整机产品的市场需求量大增，芯片的出货量会持续上升，半导体产业前景将十分诱人。预计2013年与2014年全球销售额可分别达到3220亿美元与3370亿美元，增长率分别为7.2%与4.4%。中国PC、手机及数字消费电子等整机产品的制造向地区转移，带动了上游芯片市场需求的增加。其中，PC首次成为中国大陆半导体市场最大的应用领域，对高阶芯片的需求量也大幅增长。当前半导体产业的应用热点已从最初的计算机、通信扩展至消费类电子、新能源、汽车电子等领域。随着产业发展的变革，半导体行业已从单一垂直化生产向现在的扁平化结构转变，国际分工日益明显。在日益激烈的国际竞争中，世界各地遵循成本效益原则形成了以美国为主导的高端产品设计与关键技术制造，以日本、韩国为核心的大众消费品生产，以及以中国台湾及大陆地区为主体的加工封装业共同发展的产业格局。受生产要素成本以及半导体产业自身发展周期性波动的影响，世界半导体产业呈现向具有成本优势、市场优势的发展中国家产业链转移的趋势。作为经济高速增长的发展主体，我国依托庞大的市场需求及生成要素成本优势成为国际半导体产业转移的主要目的地，以欧美、台湾地区为主的大型半导体制造业通过OEM、并购、合资等多种方式向我国转移半导体产业。智研数据研究中心发布的《2013-2017年中国半导体运行态势与投资前景评估报告》共十二章。在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家海关总署、国家经济信息中心、中国半导体行业协会、中国行业研究网、国内外相关报刊杂志的基础信息以及半导体专业研究单位等公布和提供的大量资料。本半导体行业报告，对我国半导体的行业现状、市场各类经营指标的情况、关联产业的发展状况、重点企业状况、产业竞争格局等内容进行详细的阐述和深入的分析，着重对半导体市场发展动向作了详尽深入的分析，对半导体未来的发展趋势作了审慎的判断，为半导体产业投资者寻找新的投资机会。最后阐明半导体行业的投资空间，指明投资方向，提出研究者的战略创新建议，以供投资决策者参考。

报告目录第一章 半导体的概述第一节 半导体行业的简介一、半导体二、本征半导体三、多样性及分类第二节 半导体中的杂质一、PN结二、半导体掺杂三、半导体材料的制造第三节 半导体的历史及应用一、半导体的历史二、半导体的应用三、半导体的应用领域 第二章 半导体行业的发展概述第一节 半导体行业历程一、中国半导体市场规模成长过程二、全球半导体行业市场简况三、中国半导体行业市场简况四、中国在国际半导体行业地位五、全球半导体行业市场历程第二节 中国集成电路回顾与展望一、十年发展迈上新台阶二、机遇与挑战并存三、着力转变产业发展方式四、充分推动国际合作与交流第三节 半导体行业的十年变化一、半导体产业模式fablite的新思维二、全球代工版图的变化三、推动产业发展壮大的捷径四、三足鼎立五、两次革命性的技术突破六、尺寸缩小可能走到尽头七、硅片尺寸的过渡八、3D封装与TSV最新进展九、未来半导体行业的趋向十、2000-2012年在半导体行业中发生的重要事件 第三章 化合物半导体电子器件研究与进展第一节 化合物半导体电子器件的出现一、化合物半导体电子器件简述二、化合物半导体电子器件发展过程三、化合物半导体电子器件发展难题第二节 化合物半导体领域发展现状一、化合物半导体领域研究背景二、化合物半导体领域发展现状三、关注化合物半导体的一些难题第三节 化合物半导体的未来趋势一、引领信息器件频率、二、高迁移率化合物半导体材料三、支撑信息科技创新突破四、引领绿色微电子发展五、化合物半导体的期望 第四章 功率半导体技术与发展第一节 功率半导体概述一、功率半导体的重要性二、功率半导体的定义与分类第二节 功率半导体技术与发展状况一、功率二极管二、功率晶体管三、晶闸管类器件四、功率集成电路五、功率半导体发展探讨 第五章 半导体集成电路技术与发展第一节 半导体集成电路的总体情况一、集成电路产业链格局日渐完善二、集成电路设计产业集群效应日益凸现三、集成电路设计技术水平显著提高四、人才培养和引进开始显现成果第二节 集成电路设计一、自主知识产权CPU二、第三代移动通信芯片三、数字电视芯片四、动态随机存储器五、智能卡专用芯片六、第二代居民身份证芯片第三节 集成电路制造一、极大规模集成电路制造工艺二、技术成果推动了集成电路制造业的发展三、面向应用的特色集成电路制造工艺第四节 半导体集成电路封装一、半导体封装产业的历程二、集成电路封装产业保持增长三、集成电路封装的突破四、集成电路封装的发展 第六章 全球半导体行业经济分析第一节 金融危机后的半导体行业一、美国经济恶化将影响全球半导体行业二、日本大地震影响全球半导体产业链上游三、全球半导体行业仍呈稳健成长趋势四、全球经济刺激计划带动半导体行业复苏五、全球半导体行业经济复苏中一马当先第二节 全球半导体行业经济数据透析一、2012年半导体的销售额二、2011年半导体行业的市场规模三、2012年半导体行业产值 第七章 全球半导体行业的发展趋势第一节 半导体行业发展方向一、半导体硅周期放缓二、半导体产业将是独立半导体公司的天下三、推动未来半导体产业增长的主动力量四、摩尔定律不再是推动力五、SOC已经遍地开花六、整合、七、私募股权投资公

司开始瞄准业界八、无晶圆厂IC公司越来越发达第二节 新世纪MEMS技术创新发展一、MEMS技术的发展二、新兴MEMS器件的发展三、发展的机遇第三节 半导体集成电路产业的发展一、集成电路历史发展概况二、世界集成电路产业发展的一些特点和趋势三、集成电路产业的机遇和挑战四、集成电路产业发展及对策建议五、中国集成电路产业发展路径六、集成电路产业前瞻第四节 全球半导体行业的障碍及影响因素一、半导体行业主要障碍二、影响半导体行业发展的因素 第八章 中国半导体行业的经济及政策分析第一节 中国半导体行业的冲击一、上海半导体制造设备进口主要特点二、上海半导体制造设备进口激增的原因三、强震造成的问题及建议第二节 半导体行业经济发展趋势明朗一、我国半导体行业高度景气阶段二、我国半导体行业快速增长原因分析三、我国半导体行业增长将常态化四、半导体行业蕴藏机会第三节 半导体行业政策透析一、中国半导体产业发展现状二、中国半导体的优惠扶持政策三、中国大陆半导体产业的政策尴尬 第九章 中国半导体行业机会第一节 产业分析一、太阳能电池产业二、IGBT产业三、高亮LED产业四、光通信芯片产业第二节 中国半导体产业面临发展机会一、太阳能电池产业发展现状二、中国IGBT产业市场发展潜力三、高亮LED产业四、光通信芯片产业 第十章 中国半导体集成电路产业的发展与展望第一节 北京集成电路产业一、北京集成电路产业发展回顾二、北京集成电路产业发展展望第二节 江苏省集成电路产业发展与展望一、江苏省集成电路产业发展回顾二、江苏省集成电路产业发展环境三、江苏省集成电路产业发展展望第三节 上海集成电路产业发展与展望一、十年辉煌成果二、上海集成电路产业在全球、三、上海集成电路产业发展环境日益优越四、上海集成电路产业的美好发展前景第四节 深圳集成电路产业发展与展望一、地区产业发展二、产业结构与技术创新能力三、资源优化与整合经验四、地区产业发展环境五、深圳IC设计产业在“十二五”期间的发展目标第五节 中国半导体行业在创新中发展一、2002-2011年产业发展状况二、产业发展面临的问题三、产业发展的任务 第十一章 中国半导体企业的发展状况第一节 中国南玻集团股份有限公司一、公司概况二、2011-2012年公司财务比例分析三、公司未来发展第二节 方大集团股份有限公司一、公司概况二、2011-2012年公司财务比例分析三、公司未来发展第三节 有研半导体材料股份有限公司一、公司概况二、2011-2012年公司财务比例分析三、公司未来发展第四节 吉林华微电子股份有限公司一、公司概况二、2011-2012年公司财务比例分析三、公司未来发展第五节 南通富士通微电子股份有限公司一、公司概况二、2011-2012年公司财务比例分析三、公司未来发展第六节 江西联创光电科技股份有限公司一、公司概况二、2011-2012年公司财务比例分析三、公司未来发展第七节 上海贝岭股份有限公司一、公司概况二、2011-2012年公司财务比例分析三、公司未来发展第八节 天水华天科技股份有限公司一、公司概况二、2011-2012年公司财务比例分析三、公司未来发展第九节 宁波康强电子股份有限公司一、公司概况二、2011-2012年公司财务比例分析三、公司未来发展第十节 大恒新纪元

科技股份有限公司一、公司概况二、2011-2012年公司财务比例分析三、公司未来发展 第十二章 2013-2017年半导体行业发展环境第一节 创新是半导体行业发展的推动力一、延续平面型CMOS晶体管—全耗尽型CMOS技术二、采用全新的立体型晶体管结构三、新沟道材料器件四、新型场效应晶体管第二节 硅芯片业的重要动向一、从Apple和Intel二类IT公司转型说起二、软硬融合三、业务融合四、服务至上第三节 2013-2017年半导体行业预测一、无线半导体行业进一步整合二、英特尔公司获得ARM公司Cortex处理器授权三、三星大量生产调制解调器四、苹果公司推出基于iOS的MacBookAir笔记本电脑五、电信基础设施行业进一步结构调整六、分销协议七、手机业的并购与重组八、2013年年中苹果公司推出量身打造的“迷你”iPhone九、Windows8和WindowsPhone十、2013年下半年苹果公司推出智能电视第四节 半导体产业三大发展趋势一、多样化二、平台化发展三、低功耗到云端

图表目录
图表：2001-2012年我国集成电路销售额及增长率
图表：2001-2012年我国集成电路设计业、制造业和封测业销售收入情况
图表：2009-2012年台积电全球代工市场份额
图表：2012年全球代工排名
图表：硅片尺寸过渡与生存周期
图表：“申威1”处理器
图表：“申威1600”处理器
图表：“神威蓝光”高性能计算机系统
图表：国家首款卫星数字电视信道接收芯片GX1101及高频头
图表：国家首款有线数字电视信道接收芯片GX1001及高频头
图表：国家首款数字视频后处理芯片GX2001及应用开发板
图表：国产首款解调解码SoC芯片GX6101构成的开发板
图表：CX1501+GX3101构成DTMB/AVS双国际机顶盒
图表：国产动态随机存储器芯片
图表：山东华芯DDR2芯片构筑的内存条及应用
图表：2011年封装市场企业数量统计
图表：我国主要IC封测企业
图表：我国主要半导体分立器件封测企业
图表：我国主要封装测试设备与模具生产企业
图表：我国主要LED封装企业
图表：国内主要金属、陶瓷封装企业
图表：国内电子封装技术教育资源
图表：国内集成电路封装测试业统计表
图表：国内封装测试企业的地域分布情况
图表：2010年中国半导体创新产品和技术的IC封装与测试技术
图表：日本国内主要半导体企业受大地震影响情况
图表：我国半导体行业销售增长情况
图表：我国半导体行业销售利润率增长情况
图表：我国集成电路产量及同比增长情况
图表：我国半导体分立器件产量及同比增长情况
图表：我国集成电路出口及贸易平衡情况
图表：全球电脑季度出货量及同比增长情况
图表：全球智能手机季度出货量及同比增长情况
图表：全球半导体行业销售收入及同比增长情况
图表：全球半导体行业产能利用率情况
图表：全球半导体设备订单出货比变化情况
图表：我国主要半导体产品市场价格指数走势情况
图表：我国集成电路销售收入及同比增长情况
图表：全球计算机出货量及同比增长情况
图表：我国集成电路出口额及同比增长情况
图表：2006-2011年IC进口额及占比
图表：2012年电子元器件价格指数
图表：螺纹管HRB33520MM上海市场行情
图表：2003-2011年北京集成电路销售

收入及增长率图表：2003-2011年北京集成电路产业各环节图表：2003-2011年北京集成电路制造企业销售收入及增长率图表：2003-2011年北京集成电路封装和测试企业销售收入及增长率图表：2003-2011年北京集成电路产业装备材料企业销售收入及增长率图表：江苏省半导体企业风分布图表：2002-2011年江苏省集成电路产业销售收入图表：2002-2011年江苏省半导体分立器件销售收入图表：2005-2011年江苏省半导体分立器件销售收入占全国同业比重图表：2002-2011年江苏省集成电路产业销售收入占全国同业比重图表：2001-2011年的十年间上海集成电路产业销售规模和增长率图表：2001-2011年上海集成电路产量规模图表：2001-2011年上海集成电路产业出口额变化图表：2001-2011年上海集成电路产业累积投资额图表：2001-2011年上海集成电路产业的企业数量及从业人数图表：2001-2011年上海集成电路产业技术水平图表：2001-2011年上海集成电路产业占全球、全国半导体产业的比重图表：2011-2015年上海集成电路产业的销售规模及增长率图表：2004-2011年深圳IC设计企业销售额图表：2011销售额前25名深圳IC设计企业图表：2011年深圳集成电路设计企业人数分布图表：深圳市典型IC设计企业设计水平图表：深圳市IC设计企业特征线宽分布图表：深圳市IC设计企业IP使用情况图表：2002-2011年深圳集成电路设计企业销售额图表：2002-2011年深圳市IC设计机构数量图表：深圳IC制造企业情况图表：2002-2011年半导体销售额增长情况图表：2002-2011年集成电路销售额增长情况图表：2002年集成电路产业结构图表：2011年集成电路产业结构图表：2011-2012年中国南玻集团股份有限公司偿债能力分析图表：2011-2012年中国南玻集团股份有限公司资本结构分析图表：2011-2012年中国南玻集团股份有限公司经营效率分析图表：2011-2012年中国南玻集团股份有限公司获利能力分析图表：2011-2012年中国南玻集团股份有限公司发展能力分析图表：2011-2012年中国南玻集团股份有限公司现金流量分析图表：2011-2012年中国南玻集团股份有限公司投资收益分析图表：2012年中国南玻集团股份有限公司资产负债分析图表：2012年中国南玻集团股份有限公司利润分配分析图表：2011-2012年方大集团股份有限公司偿债能力分析图表：2011-2012年方大集团股份有限公司资本结构分析图表：2011-2012年方大集团股份有限公司经营效率分析图表：2011-2012年方大集团股份有限公司现金流量分析图表：2011-2012年方大集团股份有限公司投资收益分析图表：2011-2012年方大集团股份有限公司获利能力分析图表：2011-2012年方大集团股份有限公司发展能力分析图表：2012年方大集团股份有限公司资产负债分析图表：2012年方大集团股份有限公司利润分配分析图表：2011-2012年有研半导体材料股份有限公司偿债能力分析图表：2011-2012年有研半导体材料股份有限公司资本结构分析图表：2011-2012年有研半导体材料股份有限公司经营效率分析图表：2011-2012年有研半导体材料股份有限公司现金流量分析图表：2011-2012年有研半导体材料股份有限公司获利能力分析图表：2011-2012年有研半导体材料股份有限公司发展能力分析图表：2011-2012年有研半导体材料股份有限公司投资收益分析

图表：2012年有研半导体材料股份有限公司资产负债分析图表：2012年有研半导体材料股份有限公司利润分配分析图表：2011-2012年吉林华微电子股份有限公司偿债能力分析图表：2011-2012年吉林华微电子股份有限公司资本结构分析图表：2011-2012年吉林华微电子股份有限公司经营效率分析图表：2011-2012年吉林华微电子股份有限公司现金流量分析图表：2011-2012年吉林华微电子股份有限公司获利能力分析图表：2011-2012年吉林华微电子股份有限公司发展能力分析图表：2011-2012年吉林华微电子股份有限公司投资收益分析图表：2012年吉林华微电子股份有限公司资产负债分析图表：2012年吉林华微电子股份有限公司利润分配分析图表：2011-2012年南通富士通微电子股份有限公司偿债能力分析图表：2011-2012年南通富士通微电子股份有限公司资本结构分析图表：2011-2012年南通富士通微电子股份有限公司获利能力分析图表：2011-2012年南通富士通微电子股份有限公司发展能力分析图表：2011-2012年南通富士通微电子股份有限公司投资收益分析图表：2011-2012年南通富士通微电子股份有限公司现金流量分析图表：2011-2012年南通富士通微电子股份有限公司经营效率分析图表：2012年南通富士通微电子股份有限公司资产负债分析图表：2012年南通富士通微电子股份有限公司利润分配分析图表：2011-2012年江西联创光电科技股份有限公司偿债能力分析图表：2011-2012年江西联创光电科技股份有限公司资本结构分析图表：2011-2012年江西联创光电科技股份有限公司投资收益分析图表：2011-2012年江西联创光电科技股份有限公司发展能力分析图表：2011-2012年江西联创光电科技股份有限公司获利能力分析图表：2011-2012年江西联创光电科技股份有限公司现金流量分析图表：2011-2012年江西联创光电科技股份有限公司经营效率分析图表：2012年江西联创光电科技股份有限公司资产负债分析图表：2012年江西联创光电科技股份有限公司利润分配分析图表：2011-2012年上海贝岭股份有限公司偿债能力分析图表：2011-2012年上海贝岭股份有限公司资本结构分析图表：2011-2012年上海贝岭股份有限公司经营效率分析图表：2011-2012年上海贝岭股份有限公司获利能力分析图表：2011-2012年上海贝岭股份有限公司发展能力分析图表：2011-2012年上海贝岭股份有限公司投资收益分析图表：2011-2012年上海贝岭股份有限公司现金流量分析图表：2012年上海贝岭股份有限公司资产负债分析图表：2012年上海贝岭股份有限公司利润分配分析图表：2011-2012年天水华天科技股份有限公司获利能力分析图表：2011-2012年天水华天科技股份有限公司偿债能力分析图表：2011-2012年天水华天科技股份有限公司资本结构分析图表：2011-2012年天水华天科技股份有限公司现金流量分析图表：2011-2012年天水华天科技股份有限公司发展能力分析图表：2011-2012年天水华天科技股份有限公司经营效率分析图表：2011-2012年天水华天科技股份有限公司投资收益分析图表：2012年天水华天科技股份有限公司资产负债分析图表：2012年天水华天科技股份有限公司利润分配分析图表：2011-2012年宁波康强电子股份有限公司资本结构分析图表：2011-2012年宁波康强电子股份有限公司偿债

能力分析图表：2011-2012年宁波康强电子股份有限公司获利能力分析图表：2011-2012年宁波康强电子股份有限公司经营效率分析图表：2011-2012年宁波康强电子股份有限公司发展能力分析图表：2011-2012年宁波康强电子股份有限公司现金流量分析图表：2011-2012年宁波康强电子股份有限公司投资收益分析图表：2012年宁波康强电子股份有限公司资产负债分析图表：2012年宁波康强电子股份有限公司利润分配分析图表：2011-2012年大恒新纪元科技股份有限公司获利能力分析图表：2011-2012年大恒新纪元科技股份有限公司偿债能力分析图表：2011-2012年大恒新纪元科技股份有限公司资本结构分析图表：2011-2012年大恒新纪元科技股份有限公司经营效率分析图表：2011-2012年大恒新纪元科技股份有限公司发展能力分析图表：2011-2012年大恒新纪元科技股份有限公司现金流量分析图表：2011-2012年大恒新纪元科技股份有限公司投资收益分析图表：2012年大恒新纪元科技股份有限公司资产负债分析图表：2012年大恒新纪元科技股份有限公司利润分配分析

详细请访问：<http://www.abaogao.com/b/dianzi/338477T2DJ.html>